公司代码:688709 公司简称:成都华微

成都华微电子科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析四、风险因素”。

3.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第九次会议审议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.49元(含税)。截至2025年12月31日公司总股本636,847,026股,以此计算合计拟派发现金红利人民币31,205,504.27元(含税)。本次公司现金红利金额占公司2025年度合并报表归属于母公司所有者净利润的20.32%,不送红股,不进行资本公积转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

该利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后实施。

8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

1.公司简介

1.1公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	成都华微	688709	/

1.2公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李春妍	蒋文明、蔡进
联系地址	四川省成都市双流区双江路二段688号	四川省成都市双流区双江路二段688号
电话	028-85136118	028-85136118
传真	028-85187895	028-85187895
电子信箱	investors@csmsc.com	investors@csmsc.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

成都华微主要从事特种集成电路的研发、生产、检测、销售和服务,公司产品涵盖数字集成电路产品和模拟集成电路产品,其中数字集成电路包含了可编程逻辑器件(FPGA/CPLD/SoPC/RF-FPGA)、MCU/SoC/SIP系统级芯片、存储器、TSN时间敏感网络芯片等,模拟集成电路包含了模数/数模转换器(AD/DA)芯片、接口和驱动电路、电源管理等,同时为客户提供ASIC/SoC系统芯片级解决方案。产品广泛应用于尖端技术领域,作为特种集成电路配套骨干企业,经过多年的市场验证,公司的产品已得到国内特种整机电路行业下游主流厂商的认可,核心产品高速高精度ADC以及高精度ADC、CPLD/FPGA处于国内领先地位,TSN国队核心专家受商业航天邀请参与《箭载时间敏感网络(TSN)技术规范》的制定,持续推动TSN技术在高端装备领域的落地与应用。

同时,公司建立了特种集成电路检测线,拥有中国合格评定国家认可委员会CNAS认证的国家级检测中心。中航成飞设计研究所指定元器件检验站资质认证,并通过中国商飞(COMAC)审核,获试验服务平台合格供方认证,具有较为完备的集成电路成品测试能力。

(3).报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)技术迭代推动高性能产品的不断发展

①FPGA产品面向智能异构与射频直采数据处理等方面创新迭代

可编程逻辑器件的发展紧密依托于先进的工艺制程以及创新的封装工艺方案这些技术显著提升了芯片的集成度、性能和可靠性,结合CPU技术的持续演进,包括多核架构、能效优化和指令集扩展,以及高速射频直采型模数转换器的突破,实现了智能异构计算加速平台芯片的开发。这一平台通过整合不同的计算、处理以及采样单元,为高带宽、大动态范围以及智能数据处理方面的进步提供了集成化支撑,从而推动雷达通讯、人工智能等领域的创新,具体体现在传输处理的延迟显著降低和传输数据速率的大幅提升,例如在5G通信、自动驾驶雷达系统和智能感知设备中实现更高效、实时的数据处理与传输。在“十四五”规划期间,公司主要完成了大规模FPGA、集成CPU的SOPC以及集成高速ADC和DAC的RF-FPGA样品的研制与验证,这些样品在性能测试中表现出优异的信号处理能力和功耗控制,为后续产品化与市场应用奠定了坚实技术基础。目前,公司正在积极研发集成AI和CPU的AISOPC产品,处于智能异构技术发展的初期阶段,正逐步探索异构计算在高效能处理中的广泛应用潜力,如云计算数据中心、边缘计算节点和物联网终端设备,以应对未来智能社会对高性能、低功耗计算解决方案的多样化需求。

②模数转换器技术产品面向超高速大动态以及超高精度方面持续耕耘

高速数模转换器方面,公司已成功研制出采样率高达1289GSps、分辨率10bit的高速射频直采ADC芯片,具备超宽带宽、低功耗与高信噪比特性,支持L/S/C/X波段全频段直接采样。该产品突破了传统中频采样架构瓶颈,显著简化系统链路,降低延迟,并已通过雷达整机环境下的长期可靠性验证,进入小批量试产阶段。

同时,公司已经成功进入零中频收发机开发阶段,聚焦高集成度、低功耗与多频段兼容性设计,重点突破I/O通道增益/相位一致性校准、本振泄漏抑制及宽带噪声建模等关键技术,首款基于万次跳频功能的零中频收发机产品已推向市场。

高精度数模转换器方面,公司已成功突破32bit、38.4k采样率的高精度 Δ Σ型ADC芯片,具备超低噪声、超高线性度与优异的温漂稳定性,攻破四阶 Δ Σ模拟调制器与三级数字滤波器架构设计与数字滤波算法协同优化难题,相关产品已通过高精度传感器与精密仪器领域的功能与环境适应性测试,已成功推向市场试用。

公司通过定制化规则文件开发,完善抗辐照结构的验证;用skill按需优化调整pcell,构建半定制化PDK的方式,完成耐辐照ADC产品设计验证闭环,相关产品已通过辐照试验验证。

③片上集成系统与智能算力芯片技术面向边缘侧NPU架构方面构建生态

基于自主研发的NPU架构,公司推出的边缘侧AI芯片已成功实现12Tops的算力水平,并在此基础上进一步突破了更高算力瓶颈,成功研制出性能达64Tops的芯片产品。该芯片支持INT4、INT8及FP16多精度混合计算能力,能够灵活应对不同计算复杂度与能效要求的AI任务。在软件与系统层面,芯片依托国产化操作系统及全国产化硬件平台,完成了端侧模型的轻量化部署与推理优化,显著提升了在资源受限环境下的运行效率。该方案已适配视觉识别任务及仿目标自我迭代算法,并在实际应用场景中开展了系统的功能化测试与验证。

展望“十五五”期间,公司将进一步加强AI芯片与SoC的深度融合,推动计算架构向存算一体方向演进,致力于提升能效比与计算密度。同时,公司将加快相关芯片及解决方案在智能驾驶、工业质检等典型场景的规模化落地应用,并同步构建覆盖开发、部署、优化全流程的自主安全AI工具链,以支撑更广泛的产业智能化需求。

④微控制器系统技术面向RISC-V架构构建国产化MCU架构与实时操作系统深度融合

AI融合趋势加深,边缘AI使MCU能处理高性能数据并实时决策,近年来具备AI功能的MCU产品在特种领域及汽车电子、智能家居等领域占据重要地位。集成度持续提高,将AI加速器、通信模块、传感器等多模块集成于单芯片,简化设计并降低功耗成本。架构创新与制程进步推动多核异构设计,28nm、18nm等先进制程逐步应用。RISC-V架构兴起为国内MCU产业带来机遇,其开放性和灵活性预计将显著促进创新。

公司已完成RISC-V指令集架构的深度定制与扩展,成功研制包含自主设计的32位RISC-V内核的轻量化MCU产品,其内核采用3级流水线设计,最高工作频率为20MHz,并支持硬件乘法和除法指令,为轻量级计算任务提供了基础算力保障芯片结合了多层次低功耗设计技术,实现了业界领先的功耗控制,具体表现为:在待机(Standby)模式下,功耗小于1μA,并能在150微秒内快速唤醒。芯片内置了12位精度、采样率达1MSPS的ADC和DAC,以及比较器,能够直接处理传感器信号。在数字接口方面,它提供了包括2个USART、1个LPUART、SPI、I2C以及一个CAN 2.0总线控制器在内的丰富外设,满足了工业控制和物联网设备的连接需求,且内置64KB嵌入式闪存(eFlash)和8KB SRAM,为适应小型化设备,提供了QFN20(3mm×3mm)和DFN20(4mm×4mm)等多种小型封装形式。公司将开展基于张量运算扩展指令集的研究,旨在推动人工智能计算平台从异构走向同构,使得开发者能更便捷地进行模型部署。

⑤接口芯片技术面向高集成度与高效率方面进行关键技术攻关

采用PAM4调制技术将单通道带宽提升至32Gbps,降低信号衰减。采用uBGA、WLP等先进封装技术缩小芯片面积,适配可穿戴设备。结合电源门控技术实现电源域动态管理,进一步降低静态功耗。协议兼容与扩展性:单芯片集成USB、I2C、SPI等多种接口协议,增强系统灵活性。通过可编程FPGA架构支持协议动态切换,适应工业物联网中异构设备的互联需求。

在传统总线接口应用方面,公司已有相关设计方案,采用专用芯片实现电平转换,并设计了包括终端匹配电阻、高性能泄放二极管在内的完整保护电路,以提供最高正负15KV的ESD防护,确保在严苛环境下的通信可靠性。

电平转换器方面,通过电路创新专利,致力于解决高集成度芯片中的多电压域管理和功耗问题,并避免因反相器下管无法完全关闭而导致的漏电流,显著提升多电压域切换速度与静态功耗控制精度。

可靠性设计方面,聚焦板级应用电磁兼容性优化与容错机制设计,为用户提供板级设计技术支持,进一步提升产品整体抗干扰能力。

⑥电源管理芯片技术面向低噪声、高电源抑制比、低导通电阻方向发展

随着通信系统的工作频率与采样速率不断提升,其核心时钟、频率源及信号采样电路对供电电源的噪声、纹波特性和电源抑制比(PSRR)提出了更严苛的要求。当前国际顶尖产品的噪声水平已低于1μVrms,PSRR超过90dB,输出电流可达5A以上。“十四五”期间,公司电源管理类产品主要朝着高能效、大电流输出与高集成度方向推进,成功研制超低噪声LDO和高效率、宽电压范围的DC-DC产品,已实现最高输入电压范围可达4.5V-100V,输出负载电流最高可达36A,转换效率高达93%的高性能电源管理芯片,为整体供电系统的负载点电源需提供更高的电流驱动能力,同时在有限空间内最大化功率输出,电源的转换效率、电流输出能力及功率密度。

⑦主控芯片最小系统、高速信号采集系统以及微控制系统集成解决方案

特种集成电路不断向高端化、系统化、智能化、小型化、低功耗方向加速延伸。集成电路采用系统级芯片设计或封装,可以进一步高效地实现相关电路的高度集成化,有效地降低电子信息系统产品的开发成本,缩短开发周期,进一步实现性能、功耗、稳定性、工艺难度几方面影响因素的平衡,进一步提高产品竞争力,已经成为当前业界主要的产品开发理念和方向。

公司加速推进“核心技术+系统方案”的战略转型,依托在高速AD/DA、高性能FPGA及SoC领域的多年技术积累,构建了覆盖芯片设计、固件开发、系统集成等全栈式解决方案能力,形成从IP核、芯片、板卡到系统级软硬件协同优化的完整技术闭环。公司已经成功研制多款面向射频直采、主控芯片最小应用系统、陀螺仪信号采集处理、车载以太网系统、微型计算机系统等典型应用场景的专用SiP模块,集成主控MCU、高速存储、电源管理及定制化I/O接口,面积较传统PCB方案缩减60%以上,互连延迟降低40%,已应用于相关技术领域。在可靠性方面,公司通过构建了多系统集成芯片的保障体系,覆盖芯片级、板级与系统级的全链条。

⑧场景化应用板级系统面向高速信号采集处理、时间敏感网络模组方面融合升级

在高速信号采集处理系统方面,公司实现了光耦通信技术、超声扫描技术、量子通信技术等多方面信号处理技术的重大突破,相关技术可广泛应用于通信、高端仪器仪表和科学研究等领域,显著提升了信号处理的可靠性与效率。通过采用自研的高速模数转换器,其采样率高达数GSPS,结合高性能FPGA产品的同时,结合自主开发的同步技术以及信号处理算法,确保了多源信号的高效整合与优化,从而在复杂电磁环境下实现精准数据采集与处理。此外,公司还提供从硬件设计、算法优化到系统集成的一站式解决方案,帮助用户快速部署并降低开发成本,满足雷达、测试测量和高端仪器等多样化需求。

在时间敏感网络(TSN)模组方向,公司突破了高精度时钟同步算法与硬件时间戳引擎关键技术,通过创新设计实现了端到端抖动小于50纳秒、同步精度达到±10纳秒的确定性传输能力,这对于工业自动化、智能交通和实时控制系统的低延迟通信至关重要。公司为用户提供FPGA与TSN IP融合的芯片以及对应的模组产品,这些芯片集成了高效的逻辑资源与专用TSN处理单元,支持灵活配置和低功耗运行。模组全面支持IEEE 802.1AS、Qbv、Qbu等TSN核心协议栈,并兼容更多扩展标准,确保网络中的时间敏感流量得到优先调度。同时,产品支持纳秒级时间戳标记与硬件级流量整形,增强了数据传输的确定性和可靠性,为智能制造、车载网络和航空航天等领域提供了高性能的网络基础设施。

(2)工艺进阶与新兴技术融合演进

根据行业权威数据显示,国内特种集成电路市场呈现增长态势。全球半导体贸易统计协会(WSTS)数据显示,2025年全球半导体市场规模达7,956亿美元,同比增长26.2%,为特种集成电路产业提供了广阔发展空间。

①可编程计算技术:向更深度的异构集成、更高性能、更低功耗、更广泛的应用领域发展,国内需在整体架构、资源规模、数据带宽、计算性能、AI算力以及EDA软件,流片工艺和封装工艺等方面不断突破。

②转换器与接口芯片技术:“十五五”期间,精密转换器与接口芯片将向更高精度、更低功耗、更小封装和更强智能化演进,技术融合(如AI与模拟技术结合)与新材料(如GaN/SiC)应用成为关键推动力。高速高精度ADC将持续突破数字校准技术,重点发展实时校准算法以应对动态场景需求;接口芯片将进一步提升传输速率与协议兼容性,适应工业物联网与车规级应用的严苛要求。

③SoC与AI芯片技术:前沿制程将向3nm/2nm跃进,同时探索光子芯片、量子芯片等非硅基技术路径,构建多元化技术生态。AI芯片架构向“存算一体化”演进,可提升大模型推理效率10倍以上,车规级芯片实现功能安全等级全栈自主化。RISC-V架构在边缘计算领域渗透率将突破40%,国产企业需平衡兼容性与自主性,突破ARM生态壁垒。

④电源管理技术:为提升系统能效并减少线路损耗,在服务器、数据中心与算力中心等领域,48V总线负载点多相电源有望成为新趋势,电源将集成PMBus等数字控制接口,通过与上位机实时通信,依据系统状态动态调整电压,并实现工作状态监控与故障诊断,从而优化整体能效。

⑤TSN技术:将持续根据“场景驱动”的特点,在更多应用场景中灵活部署,进一步提升系统的可靠性和适应性,满足不同领域对高带宽、高可靠、高实时的需求。针对安全关键型应用,TSN IP内核将进一步集成高精度容错时间同步、冗余传输等可靠性设计,支持根据用户场景进行协议裁剪与定制,适应资源受限环境下的低功耗与弱计算条件。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,304,778,964.36	3,669,593,588.18	17.31	2,274,217,612.93
归属于上市公司股东的净资产	2,974,543,772.29	2,809,366,206.22	5.88	1,312,814,437.45
营业收入	759,987,312.37	603,889,863.51	25.85	926,053,722.41
利润总额	180,422,431.61	136,003,197.34	32.66	332,251,580.32
归属于上市公司股东的净利润	153,605,481.59	122,169,852.80	25.73	311,065,266.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,472,420.80	87,616,956.37	36.36	276,671,955.49
经营活动产生的现金流量净额	-344,749,421.76	25,464,993.83	不适用	53,736,512.48
加权平均净资产收益率(%)	5.20	4.83	增加0.37个百分点	27.33
基本每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00	0.57
研发投入占营业收入的比例(%)	14.87	25.46	减少10.59个百分点	21.4

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	155,667,231.84	199,257,728.61	162,727,977.16	242,334,374.76
归属于上市公司股东的净利润	21,881,762.52	13,838,727.07	26,884,591.66	91,000,400.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,407,964.66	-1,422,419.47	25,571,715.73	74,915,159.88
经营活动产生的现金流量净额	-158,271,051.37	-111,701,131.79	-112,178,188.09	37,400,949.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4.股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,056
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,190
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国振华电子集团有限公司	0	285,575,825	44.84	285,575,825	无	0	国有法人
华大半导体有限公司	0	115,707,282	18.17	115,707,282	无	0	国有法人
成都华微众志共创企业管理中心(有限合伙)	-2,613,586	46,162,960	7.25	0	无	0	其他
中电金投控股有限公司	0	13,817,668	2.17	13,817,668	无	0	国有法人
成都华微展飞伙伴企业管理中心(有限合伙)	-1,819,900	13,815,808	2.17	0	无	0	其他
成都华微同创共享企业管理中心(有限合伙)	-1,782,407	11,067,764	1.74	0	无	0	其他
四川省国投资产托管有限责任公司	-2,000,000	10,000,000	1.57	0	无	0	国有法人
成都华微共融众创企业管理中心(有限合伙)	-1,532,445	8,442,258	1.33	0	无	0	其他
成都创新风险投资有限公司	-19,080,000	7,829,133	1.23	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,565,942	4,343,559	0.68	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			1.中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司均为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的企业; 2.四川发展(控股)有限责任公司间接持有四川省国投资产托管有限责任公司100%的股权,间接持有成都创新风险投资有限公司36.79%的股权。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

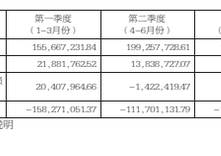
□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用√不适用

5.公司债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

(下转B389版)

证券代码:688709 证券简称:成都华微

成都华微电子科技股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	103,305,888.34	155,667,231.84	-33.64
利润总额	-58,878,893.57	24,003,185.53	-345.30
归属于上市公司股东的净利润	-67,101,947.38	21,881,762.52	-406.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,079,703.41	20,407,964.66	-389.49
经营活动产生的现金流量净额	-79,259,502.80	-158,271,051.37	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.03	-466.67
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.03	-466.67
加权平均净资产收益率(%)	-2.28	0.78	减少3.06个百分点
研发投入合计	53,924,682.36	49,679,252.23	8.56
研发投入占营业收入的比例(%)	52.20	31.91	增加20.29个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,193,691,642.78	4,304,778,964.36	-2.58
归属于上市公司股东的所有者权益	2,910,913,049.75	2,974,543,772.29	-2.14

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	432,432.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,333,081.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-885,331.57	
少数股东权益影响额(税后)	6,926.09	
合计	-8,022,243.97	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-33.64	系受行业周期性调整影响,报告期内国内特种集成电路行业订单同比下降导致
归属于上市公司股东的净利润	-406.66	系报告期内公司收入下降,销售成本、管理成本增加,影响利润实现所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-389.49	系报告期内公司利润下降导致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期增加系报告期内客户回款增加所致
基本每股收益	-466.67	系报告期内公司利润下降所致
稀释每股收益	-466.67	系报告期内公司利润下降所致
加权平均净资产收益率(%)	减少3.06个百分点	系报告期内公司利润下降所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中国振华电子集团有限公司	国有法人	285,575,825	44.84	285,575,825	0	无	0
华大半导体有限公司	国有法人	115,707,282	18.17	115,707,282	0	无	0
成都华微众志共创企业管理中心(有限合伙)	其他	44,059,004	6.92	0	0	无	0
中电金投控股有限公司	国有法人	13,817,668	2.17	13,817,668	0	无	0
成都华微展飞伙伴企业管理中心(有限合伙)	其他	12,393,968	1.95	0	0	无	0
四川省国投资产托管有限责任公司	国有法人	10,000,000	1.57	0	0	无	0
成都华微同创共享企业管理中心(有限合伙)	其他	9,676,716	1.52	0	0	无	0
成都华微共融众创企业管理中心(有限合伙)	其他	7,267,049	1.14	0	0	无	0
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,009,356	0.63	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长混合型证券投资基金	其他	2,200,000	0.35	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
成都华微众志共创企业管理中心(有限合伙)	44,059,004	人民币普通股	44,059,004
成都华微展飞伙伴企业管理中心(有限合伙)	12,393,968	人民币普通股	12,393,968
四川省国投资产托管有限责任公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
成都华微同创共享企业管理中心(有限合伙)	9,676,716	人民币普通股	9,676,716
成都华微共融众创企业管理中心(有限合伙)	7,267,049	人民币普通股	7,267,049
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	4,009,356	人民币普通股	4,009,356
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
香港中央结算有限公司	1,589,647	人民币普通股	1,589,647
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,480,781	人民币普通股	1,480,781
成都创新风险投资有限公司	1,469,133	人民币普通股	1,469,133
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司均为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的企业; 2.四川发展(控股)有限责任公司间接持有四川省国投资产托管有限责任公司100%的股权,间接持有成都创新风险投资有限公司36.79%的股权。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:成都华微电子科技股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	671,630,796.14	844,932,136.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	177,151,533.52	192,238,755.21
应收账款	1,172,007,338.74	1,189,357,305.96
应收款项融资		
预付款项	188,898,104.07	190,712,939.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,096,391.72	5,393,126.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	922,136,650.63	844,226,051.73
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,443,844.84	33,388,383.93
流动资产合计	3,187,354,659.66	3,300,248,698.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,443,163.52	20,398,906.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,032,788.00	1,032,788.00
固定资产	770,865,759.25	779,650,904.64
在建工程	10,481,496.20	4,921,659.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,713,335.83	20,153,348.49
无形资产	113,616,382.09	111,441,685.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	897,604.01	1,166,247.83
递延所得税资产	52,840,648.20	53,887,621.70
其他非流动资产	19,445,806.02	11,877,102.71
非流动资产合计	1,006,336,983.12	1,004,530,265.51
资产总计	4,193,691,642.78	4,304,778,964.36
流动负债:		
短期借款	26,971,861.00	26,971,861.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,485,331.11	26,017,939.74
应付账款	222,194,847.50	228,071,156.42
预收款项		
合同负债	5,983,666.65	4,196,833.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,847,604.12	29,365,571.26
应交税费	28,366,031.75	26,913,201.77
其他应付款	2,914,577.42	4,670,447.31
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,459,115.02	174,382,285.44
其他流动负债	777,876.66	545,588.40
流动负债合计	448,000,911.23	521,134,885.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,241,151.80	11,783,477.45
长期应付款	140,122,740.56	113,964,650.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,789,000.00	51,789,000.00
递延所得税负债	1,896,354.49	2,047,179.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	802,049,246.85	779,584,307.65
负债合计	1,250,050,158.08	1,300,719,192.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	636,847,026.00	636,847,026.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,525,400,435.05	1,521,929,210.21
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,041,049.46	73,041,049.46
一般风险准备		
未分配利润	675,624,539.24	742,726,486.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,910,913,049.75	2,974,543,772.29
少数股东权益	32,728,434.95	29,515,999.25
所有者权益(或股东权益)合计	2,943,641,484.70	3,004,059,771.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,193,691,642.78	4,304,778,964.36

公司负责人:王策 主管会计工作负责人:刘永生 会计机构负责人:刘永生

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:成都华微电子科技股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年第一季度